

平成 16年 3月期

## 決算短信 (連結)

平成 16年 5月 18日

上場会社名



株式会社東京精密

上場取引所 東

コード番号

7729

本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.accretech.jp/)

代表者 代表取締役会長 C.E.O. 大坪 英夫

問合せ先責任者 取締役業務会社執行役員社長 太田 邦正

TEL (0422) 48 - 1011

決算取締役会開催日 平成 16年 5月 18日

米国会計基準採用の有無 無

## 1. 16年 3月期の連結業績(平成 15年 4月 1日 ~ 平成 16年 3月 31日)

## (1)連結経営成績

(金額:百万円未満切捨表示)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年 3月期	62,324	32.1	5,947	219.7	5,328	322.9
15年 3月期	47,171	38.5	1,860	-	1,259	-

	当期純利益		1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円	銭	円	銭	%	%
16年 3月期	3,783	-	101	67	-	12.0	5.8	8.5
15年 3月期	74	-	1	64	1	64	0.2	1.5

(注) 持分法投資損益 16年 3月期 - 百万円 15年 3月期 - 百万円

期中平均株式数(連結) 16年 3月期 37,355,470 株 15年 3月期 37,364,354 株

会計処理の方法の変更 無

売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

## (2)連結財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
16年 3月期	94,893	29,183	30.8	780 87
15年 3月期	88,669	33,645	37.9	900 32

(注)期末発行済株式数(連結) 16年 3月期 37,354,830 株 15年 3月期 37,355,873 株

## (3)連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
16年 3月期	4,569	167	1,662	12,242
15年 3月期	3,193	4,312	1,248	6,193

## (4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 8 社 持分法適用非連結子会社数 0 社 持分法適用関連会社数 0 社

## (5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) 0 社 (除外) 0 社 持分法(新規) 0 社 (除外) 0 社

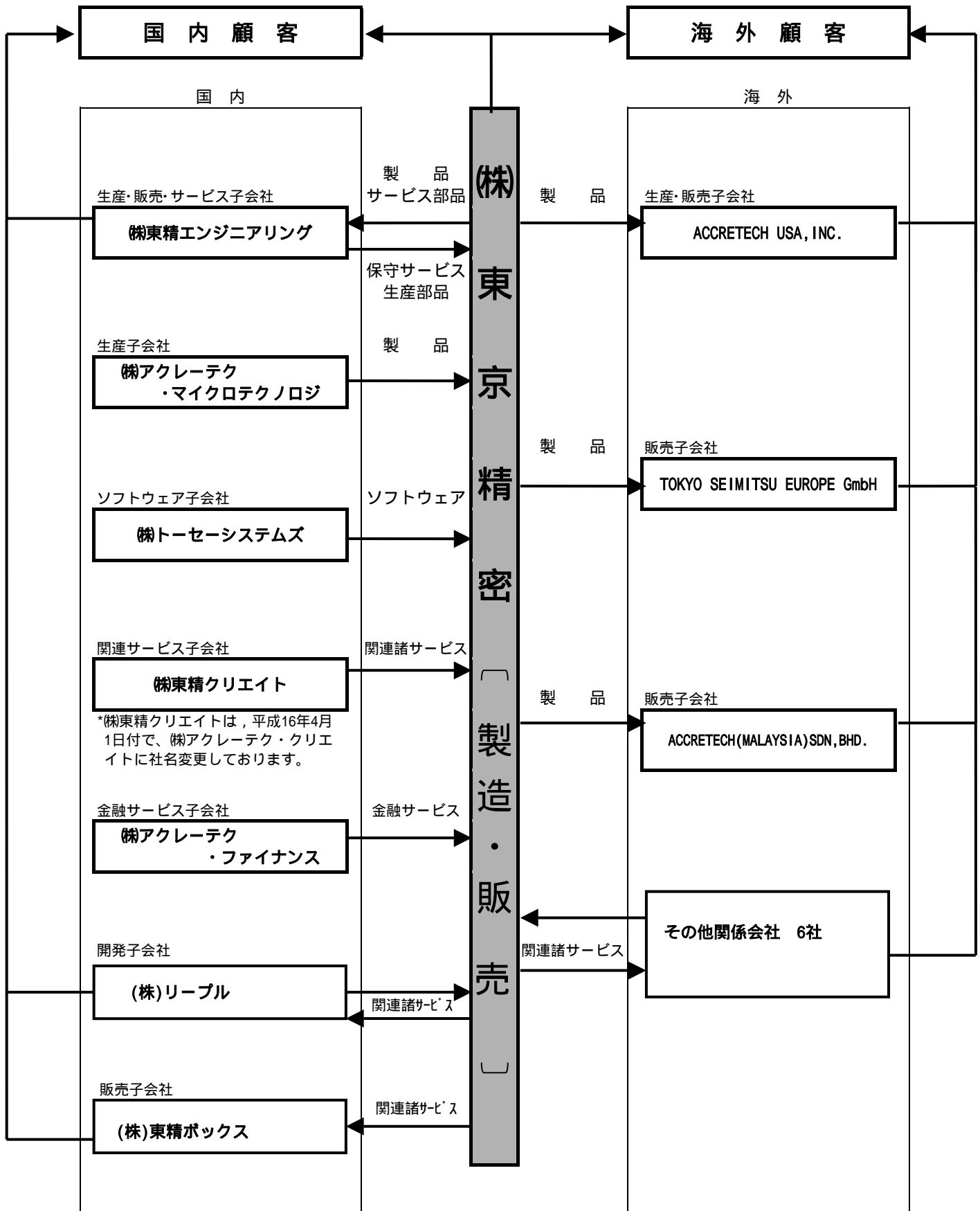
## 2. 17年 3月期の連結業績予想(平成 16年 4月 1日 ~ 平成 17年 3月 31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	41,000	7,000	3,800
通期	82,000	14,000	7,600

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 203 円 45 銭

上記の予想は、8~10頁に記載した事項等を前提としています。1

# 1. 企業集団の状況



## 2 . 経営方針

### (1) 基本方針

当社は、精密計測機器及び半導体製造用機器メーカーとして、常にお客様の高生産性に寄与する最先端技術を駆使した製品開発とカスタマーサポートに注力してまいりました。技術革新が高レベルかつ高スピードで進行する環境下、当社が発展し続けるために最も重要な事は、強い製品開発体制と適正な製品開発基準を持つことです。そこで、以下に掲げる「製品開発の原則」を当社の経営の大原則として、市場の設備投資動向の影響を最小限に抑えつつ、高成長・高収益のビジネス基盤を構築し、さらなる企業価値向上に努めております。

#### 「製品開発の原則」

世界 No.1 の製品を創る

マーケットシェア No.1 の商品は、

(a) 好況時の利益の極大化がはかれる

(b) 不況時の損失の極小化がはかれる

研究開発投資は自己資金で

技術参入障壁が高く、マーケットが大きくニーズも高い分野を狙う

相応しいパートナーを見つけ、開発コストをシェアするとともに開発の成果を共有する

また、「WIN - WIN の仕事で世界 No.1 の商品を創ろう」を当社の行動指針として制定し、「製品開発の原則」遵守を徹底して推進しております。世界 No.1 の製品開発には、各分野における最先端の技術とスピードが要求されます。そのためには、当社の培ってきたコア・テクノロジーを応用することに加え、国内外の垣根を越えて、世界 No.1 の製品創りという共通目的をもつ会社および個人と“WIN - WIN”の協力関係を築くことが不可欠です。各国、各社のもつ異文化を融合したグローバルかつハイブリッドな社風を醸成することにより、世界 No.1 の製品開発体制を構築して、真のグローバル・カンパニーとなるべく努力しております。

当社のコーポレートブランド「ACCRETECH (アクレテック)」は、「ACCRETE (= Grow Together の意味) + TECHNOLOGY」の合成語で、世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して世界 No.1 の商品を創り、皆様とともに大きく成長していくという当社の企業理念を一語で表わしたものです。

### (2) ユニークな開発体制

当社は、1988 年より各技術開発グループを製品群別に分け、グループリーダーをヘッドとするグループリーダー制を採用しています。グループリーダーは、製品開発のみならず、担当する製品群の業績全般についての責任をもち、事業計画作成、設備投資及び人材の採用など大きな権限を与えられています。

2002 年 4 月、当社の執行役員制導入に伴い、グループリーダーは、執行役員に選任されました。これにより、グループリーダー制の備えている、開発計画などのスピーディな意思決定や市場動向への迅速・柔軟な対応という長所が一層強化されました。

### (3) 利益配分に関する基本方針

当社は、成長分野において、最先端技術を駆使した世界 No.1 商品を提供することにより、企業価値を高め、株主の皆様へ利益還元を図りたいと考えております。配当につきましては、将来の事業展開のための企業体質強化に配慮の上、株主の皆様の長期的視点を重視した安定的な配当を実施してまいりたいと考えております。

内部留保金につきましては、当社が成長していくために不可欠な研究開発投資、生産設備投資などに有効に活用してまいりたいと存じます。

#### (4) 目標とする経営指標

当社は、株主の皆様が当社株式を所有する目的に沿った経営を行っております。従って、一株当たり利益の長期的な上昇とその結果としての企業価値の長期的な上昇を、経営上の重要な指標と考えています。

#### (5) 中長期的な会社の経営戦略

当社は、前記の基本方針・開発体制に基づき、「ウェーハ外観検査装置」・「ポリッシュ・グライнда」・「CMP装置」および「LEEPL転写装置」など、技術参入障壁が高く競争が少なく、マーケットも大きい、高機能・高価格の新製品を開発してきました。これらの新製品群は、いずれも当社従来製品に比して、数十倍も高い価格の製品であります。

「ウェーハ外観検査装置」・「ポリッシュ・グライнда」は2000年度に、「CMP装置」は2002年度に夫々市場投入しましたが、その後お客様の評価は年々たかまり、ビジネスとして順調に成長しています。これら半導体新製品の2003年度売上高は113億円と前年比71%増を達成いたしました。

また、「LEEPL転写装置」につきましては、2004年度からの市場投入となり、今後本格的にビジネスが立ち上がり、業績への貢献が期待されます。

半導体および半導体製造装置の市況は、2003年度下期以降急速に好転しており、2004年度～2005年度も好調裡に推移すると予想されておりますが、前回のピークには達しないとの見方もあります。

この中であって、当社は新製品群の売上・収益の拡大により、業績の既往ピーク更新を目指しています。

さらに、より長期（10年以上）のことを考えますと、当社の従来製品（計測製品、プロービングマシン、ダイシングマシンなど）が、将来、中国製品と競争する厳しい状況におかれることも想定しておく必要があります。当社は、高機能・高価格で競争の少ない新製品群の開発が長期的な対中国シフトの観点からも重要と考え推進しているものであります。

#### (6) 会社の対処すべき課題

##### 新製品事業の成功

当社は、ここ数年来、半導体新製品群の開発を積極的に進めてきましたが、「ウェーハ外観検査装置」・「ポリッシュ・グライнда」は、ビジネスとして軌道に乗り、予定通りマーケットシェアを拡大しておりますし、「CMP装置」につきましても顧客開拓が進んでいます。これらによる新製品群の売上高は、計測部門に匹敵する規模になりました。

今後は、「LEEPL転写装置」について、開発・生産・販売をより一層促進し、事業を成功させ、業績の進展に貢献させることが肝要と考えています。

##### 財務構成の改善

当社は、2001年のシリコンサイクルの落込みによるプローバの在庫増と新製品関連資産の増加などにより、財務諸比率（自己資本比率など）が低下してまいりましたが、プローバの在庫増は2002年度で解消しましたし、新製品につきましても、2003年度、着実な売上増加に伴い、資産回転率がさらに改善されました。

加えて、当社は2003年度下期に、今後の収益基盤を一層拡充する為に、CMP事業の再構築とリープル事業の収益体質強化を実施いたしました。

新製品群の販売が拡大している成長期の当社の場合、今後1~2期は、財務諸比率の緩やかな改善を甘受しなければなりません。数年後には、新製品群のフリーキャッシュフローのプラスと昨年10月に発行した転換社債型新株予約権付社債の資本への転換により、財務諸比率が格段に良くなる見通しです。

## (7) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方とその施策の実施状況

### <コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方>

経済のグローバル化が進み企業の経営環境が目覚ましい変化を遂げる中、持続的な成長を実現するには、その変化のスピードに対応できる経営体制の構築と、経営の国際標準化および株主重視経営に適合したコーポレートガバナンスの充実が不可欠と認識しております。

株主の権利の保護と平等な扱いに留意するとともに、他のステークホルダーとの円滑な関係の構築にも努めております。今後とも、適切な情報開示と透明性確保を図り、取締役会と監査役会の機能発揮によるコーポレートガバナンスの実行性確保に注力してまいります。

### <コーポレートガバナンスに関する施策の実施状況>

#### 執行役員制とカンパニー制の導入

当社は、2002年4月に執行役員制と社内カンパニー制を導入し、社内を半導体社、計測社、業務会社の3つのカンパニーに分けました。全てのオペレーションは、この3社で行うこととし、head officeとしての機能は廃止いたしました。

半導体社と計測社は、完結した組織として、夫々のお客様に一層機動的かつ迅速に対応できるように、業務会社は、間接部門の合理化を推進しております。

また、2003年4月にトップマネジメントを改正し、会長C.E.O.と社長C.O.O.を分離いたしました。会長C.E.O.は中長期の経営戦略に係わるものに専念し、日常の業務は各カンパニーの社長に委譲され、社長C.O.O.が全社的な業務執行責任を負うこととなり、経営執行体制がより明確になりました。

#### コーポレートガバナンスの実効性確保

A. 社内カンパニー制の導入に伴い、株式会社東京精密は、理論的には取締役会のみになります。取締役会は、会社の重要な業務執行について決定したり、取締役の職務執行を監督する機関ですが、当社の取締役は出身企業が多岐にわたり、様々な会社で経験を重ねた人が取締役会を構成しており、当社の取締役会はハイブリッドな組織となっております。

B. 当社は監査役制度を採用しております。当社の監査役は、当社の大株主出身の経営者で構成されており、現在3名のうち2名が社外監査役であります。当社の監査役は、報酬委員会および経営諮問委員会のメンバーを兼務し、役員の報酬その他、経営の妥当性の判断も行っています。2004年6月に社外監査役として、監査業務に詳しい有識者を1名増員し、機能の一層の充実を図る予定です。

C. 以上のように当社の取締役会および監査役会のシステムは、日本、米国、ドイツのコーポレートガバナンスの長所をミックスした制度になっています。従って、当社のコーポレートガバナンスは、極めて透明性が高く、accountabilityが明確であります。

### 3 . 経営成績及び財政状態

#### (1) 経営成績

##### 当期の概況

##### [ 業績全般 ]

当期の半導体業界は、デジタル・コンシューマ機器の好調やカメラ付携帯電話の普及さらにパソコンの需要回復などにより、上期は前年度後半からの回復基調を継続し、下期に本格回復となりました。半導体各メーカーは、生産・販売を伸ばし、収益改善も進んでいます。設備投資につきましても、上期はやや慎重でありましたが、下期は極めて積極的に推進しています。

これを反映して、当社半導体製造用機器部門の市況も下期以降急回復し、半導体既存製品、半導体新製品とも前年同期比大幅な増収・増益となりました。

計測機器部門につきましても、日本経済の景気回復が進むなか、国内市況が自動車関連産業を中心に順調に回復しており、前年同期比増収・増益を達成しました。

この結果、当期の連結売上高は 623 億 24 百万円（前期比 32.1%増）、連結経常利益は 53 億 28 百万円となりました。連結当期損益につきましては、特別損失 97 億 72 百万円を計上したため、37 億 83 百万円の損失となりました。

##### [ 各部門の概況 ]

##### A . 半導体製造用機器部門

- ( a ) 半導体製造用機器部門につきましては、国内外の半導体メーカーの積極的な設備投資動向を的確に捉え、ニーズに応えるきめ細かい営業を展開しました結果、今期の売上高は 470 億 45 百万円（前期比 40.2%増）と前年比大幅増収となりました。

利益面では、売上の増加に加え、固定費削減・変動比率引き下げなどの強力なコストダウン施策が奏効し、27 億 72 百万円の営業黒字を計上し、前期比大幅改善となりました。

下期の受注高は 348 億 13 百万円、2004 年 3 月末の受注残高は 148 億 21 百万円となり、いずれも半期受注高、期末受注残高として既往ピークを更新しました。

##### ( 地域別の状況 )

地域別に見ますと国内、韓国、及び東南アジアが好調で前年比大幅に伸長しています。上期に SARS の影響があった台湾も下期に急回復しておりますし、米国も第 4 四半期より回復が顕著になっています。中国も着実に需要が増加しており、今後が期待されます。

##### ( 製品別の状況 )

ウェーハプロ・ピングマシンにつきましては、最先端デバイス向け高精度プローバに対する更新需要と 300mm 対応の新規需要が急増しており、受注、生産、売上が大きく伸長し、No. 1 プレーヤーとしてマーケットシェアを着実に伸ばしています。

300mm ウェーハ対応の第三世代機となる最新鋭機種「UF3000」は、システム LSI などの多品種少量生産から、メモリなどの大量生産まであらゆるデバイスメーカーのニーズをカバーするフルオートタイプの超高性能プローピングマシンとして、お客様から高い支持を得ており、販売が増加しています。

ウェーハダイシングマシンにつきましても、当社製品に対する評価が高く、新規顧客も増加し、マーケットシェアが拡大した結果、当期の受注高及び3月末受注残高は2000年度の過去最高を上回りました。

300mm対応の「A-WD-300T」は生産性の高いマシンとしてお客様からの評判が高く、受注、売上が前年比急増しています。

ウェーハ外観検査装置では、「WIN-WIN50」の持つ強みである、低いCost of Ownershipや高い検出率などが高く評価され、既存ユーザーからリピートオーダーを頂くとともに、新規ユーザーも獲得しています。また、当社と株式会社日立ハイテクノロジーズが共同開発したDeep Ultra Violetタイプの「HA3000」も揃え、多岐にわたるユーザーニーズに応えています。マーケットシェアは着実に伸びており、当期の売上高は前年比大幅増となりました。

ポリッシュ・グラインダ「PG200」・「PG300」は、ウェーハの薄片化とダメージ除去を1台で実現している他に追随を許さない当社独自の製品で、ウェーハ薄片化市場におけるデファクトスタンダードとなり、売上が急増しています。

また、CMP装置につきましては、今期の売上高は前年並に止まりましたが、受注高は倍以上となっております。これは、当社のCMP装置のコンセプトや構造の優位性がお客様に浸透し、高く評価された結果で次期以降の成長が期待されます。

- (b) 研究開発につきましては、300mmウェーハへの移行や微細化が進展するなかで、市場ニーズに適合する次世代装置のタイムリーな開発に注力しております。

ダイシングマシンでは、浜松ホトニクス株式会社と業務提携し、同社が開発したステルスダイシング技術を使って、ウェーハ表面に損傷を与えず、洗浄不要、完全ブロードレスで、チップ分割を行う新型レーザダイシング装置「MAHOHDICING MACHINE」の開発を進めています。

この装置はプロセスの変更を伴う装置であり、ユーザーへの導入に時間を要しておりますが、当期に受注を獲得しており、次期には販売となります。

子会社の株式会社リープルが進めている100nm～35nmの微細回路製造用転写装置「LEEPL転写装置」の開発は順調で、複数のユーザーとのコラボレーションを活発に進め、本格的評価を行っています。

また、2001年6月、当社、株式会社リープル、ソニー株式会社の3社が、次世代リソグラフィ技術の開発促進と普及を目的に、各業界に呼びかけて、「LEEPL技術コンソーシアム」を発足させました。当初、半導体デバイスメーカー、装置メーカー、マスクメーカー、レジストメーカーの13社で発足しましたが、その後加入企業が増加し、現在では32社が活動しています。

「LEEPL転写装置」は、既存の光学系リソグラフィ装置では微細化が困難なレイヤーを処理でき、その有用性が高く評価されています。リープル技術およびマスク、レジストなどの周辺技術の開発は確実に進展しており、リープル事業が当社のコア事業に成長していくものと予想しております。

また、当社が開発している、LEEPL技術の促進に必要な「電子ビームマスク用欠陥検査装置」につきましても、計画どおり順調に進捗しており、次期に市場投入を予定しています。

## B. 計測機器部門

- (a) 計測機器部門につきましては、国内の景気が上向き中、ユーザーニーズを確実に受注に取込む営業努力により、国内を中心に売上を伸ばすことができ、売上高は152億79百万円（前期比12.3%増）となりました。

生産面でもコストダウンに注力し、営業利益も 31 億 74 百万円（前期比 10.1%増）と増益を達成しました。

汎用計測機器では、2003 年 4 月に市場投入したカールツァイス社の解析・制御技術と当社の高剛性設計技術を融合した「ザイザックス SVA」シリーズがお客様のニーズに合った製品として高い評価を受け、販売が大きく伸びました。

また、リニアモータ採用で世界最高精度と低振動を実現した表面粗さ形状測定機「サーフコムシリーズ」や高精度で好評の真円度測定機「ロンコムシリーズ」の売上が堅調に推移しました。

自動計測機器は、自動車産業の設備投資が活発であったことを反映し、自動車の部品生産ライン等で使用される「パルコムシリーズ」などが好調でありました。また新製品の「ATC 振れ測定システム」も多くのユーザーに標準採用されました。

- (b) 研究開発につきましては、カールツァイス社製の高精度アクティブスキニング方式を採用した CNC 三次元座標測定機の新シリーズ「ザイザックス SVA fusion」を開発し、2004 年 4 月より販売を開始しました。この装置は、様々な測定物に対して高精度の寸法測定のみならず、形状検査や位置検査を 1 台で可能にし、測定・検査時間を大幅に短縮します。

## [ 特別損失について ]

当社は、当期に今後の収益基盤拡充の観点より、CMP 事業の再構築とリープル事業の収益体質強化を実施し、両事業の開発関連の投資及び費用など 97 億円を特別損失に計上いたしました。内訳は、販売用ソフトウェア廃却損 34 億円、たな卸資産評価損及び廃却損 34 億円及び固定資産除却損 22 億円などであります。

## [ 利益配分について ]

当期の配当に関しましては、中間配当として 1 株当たり 15 円を実施いたしました。期末配当につきましては、当期損失となりましたが、前述の利益配分の基本方針と下記理由から 15 円を継続し、一株当り年間配当で 30 円とすることを第 81 期定時株主総会で提案させていただく予定であります。

- A. 半導体産業は、市況の急進・急落があるので短期の業績を直ちに配当に反映させることは、長期的視点で保有していただいている株主の皆様の視点と合致しないこと。
- B. 当社の財務状況と今後の損益見通し・キャッシュフロー、及び平成 16 年 3 月末末処分利益 44 億 63 百万円から、一株当り 30 円配当継続には無理のないこと。

## 次期の見通し

### [ 業績全般及び各部門の概況 ]

#### A. 半導体製造用機器部門

2004 年度の半導体市場は、デジタル・コンシューマ機器の需要増加に加え、パソコン需要の回復や第 3 世代携帯電話・車載デバイスの伸長が見込まれ、引続き堅調な伸びが予想されます。半導体メーカーの設備投資も、300mm ウェーハ関連投資の本格化などにより、拡大が期待されます。

このような状況下、当社は、2004年度の半導体製造用機器部門の経営環境について、全般的には好調に推移すると予想しており、引合い・受注動向などより考えて、ウェーハプロービングマシン、ウェーハダイシングマシンなどの既存製品及びウエーハ外観検査装置、ポリッシュ・グラインダ、CMP装置の新製品の全製品が2003年度より売上高を伸長させる見込です。

半導体製造用機器部門の2004年度の売上高は、664億円（前期比41.1%増）と予想しています。年度後半の市況は少し不透明な点もあるところから、下期について新製品は伸びるものの、マーケットシェアの高い既存製品はやや慎重な見方で計画を策定しておりますが、全体的には、既存製品、新製品とも好調に推移し、半導体部門の売上高は2000年度の既往ピーク（585億円）を更新し、過去最高となる見込です。

## B．計測機器部門

計測機器部門につきましても、2004年度は、国内において全般景況の回復に伴ない、自動車関連をはじめ工作機械、ベアリングなどの各ユーザーから堅調な需要が見込まれますし、海外も、アジア地域を中心に需要の増加が期待されます。

かかる状況下、お客様のニーズを的確に把握し受注に繋げるとともに、昨年より発売した高機能の新製品群も積極的に拡販し、2004年度売上高は、156億円（前期比2.1%増）を予定しています。

以上のような予測の下、2004年度の連結売上高は過去最高の820億円（前期比31.6%増）連結経常利益140億円（同162.8%増）、連結当期純利益76億円と予想しております。

## [利益配分について]

上記業績見通し及び前述の利益配分に関する基本方針に従い、次期配当金につきましては、安定的な配当を継続することとし、年間配当で1株当たり30円（うち中間配当金15円）を予定しております。

## (2) 財政状態

当期末における現金及び現金同等物は、前期末より60億円増加し、122億円となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは45億円の収入となりました。これは主に減価償却費（27億円）、たな卸資産の減少（31億円）などによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは1億円の支出となりました。これは設備投資支出（17億円）などによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、16億円の収入となりました。これは主に、社債の発行（180億円）、短期借入金の返済（138億円）および配当金（11億円）などによるものであります。

当期の営業キャッシュ・フローは、前期に比べ大幅に改善されていますが、次期は売上拡大や利益計上などにより、さらに営業キャッシュ・フローの好転が見込まれ、投資活動も平準化することから、より良い財務状況を構築できる見込です。

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下の通りであります。

	平成 15 年 3 月期	平成 16 年 3 月期
自己資本比率 (%)	37.9	30.8
時価ベースの自己資本比率 (%)	88.5	138.6
債務償還年数 (年)	10.5	7.9
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	12.2	15.7

自己資本比率：自己資本 / 総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額 / 総資産

債務償還年数：有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー / 利払い

注 1．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

注 2．株式時価総額は、期末株価終値 × 期末発行済株式総数により算出しています。

注 3．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

#### 将来の事象に係る記述に関する注意

この決算短信に記載されている業績見通しに関する記載内容につきましては、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。

これらは、市況、競争状況、ならびに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

#### 4 . 比較連結貸借対照表

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

科 目	前 期 (平成 15 年 3 月 31 日現在)	当 期 (平成 16 年 3 月 31 日現在)	科 目	前 期 (平成 15 年 3 月 31 日現在)	当 期 (平成 16 年 3 月 31 日現在)
資 産 の 部			負 債 の 部		
流 動 資 産	59,062	70,944	流 動 負 債	38,964	33,285
現金及び預金	6,220	12,269	支払手形及び買掛金	11,245	17,574
受取手形及び売掛金	16,180	26,554	短期借入金	19,486	5,543
たな卸資産	34,075	29,196	一年以内返済予定		
未収消費税等	364	64	長期借入金	3,297	4,311
繰延税金資産	904	2,289	一年以内償還予定		
その他流動資産	1,356	610	社債	200	200
貸倒引当金	40	40	未払法人税等	598	756
			賞与引当金	584	646
			その他流動負債	3,552	4,252
固 定 資 産	29,606	23,948	固 定 負 債	14,162	30,301
(有形固定資産)	(15,578)	(12,847)	社 債	2,050	19,850
建物及び構築物	5,762	5,342	転換社債	51	51
機械装置及び運搬具	3,868	3,022	長期借入金	8,446	6,297
工具器具備品	742	843	退職給付引当金	3,107	3,498
土地	2,919	2,919	役員退職慰労引当金	461	557
建設仮勘定	2,287	719	繰延税金負債	45	48
(無形固定資産)	(7,580)	(3,756)	負 債 合 計	53,126	63,587
ソフトウェア	6,845	3,199			
その他無形固定資産	735	557	少数株主持分	1,897	2,122
(投資その他の資産)	(6,447)	(7,343)			
投資有価証券	2,407	3,311	資 本 の 部		
長期貸付金	56	381	資 本 金	7,199	7,199
繰延税金資産	3,426	3,109	資 本 剰 余 金	11,806	11,806
その他の投資			利 益 剰 余 金	15,191	10,273
その他の資産	606	554	その他有価証券評価差額金	617	57
貸倒引当金	49	12	為替換算調整勘定	111	105
			自 己 株 式	46	49
繰 延 資 産	0	0	資 本 合 計	33,645	29,183
社債発行差金	0	0			
資 産 合 計	88,669	94,893	負 債、少数株主持分 及び資本合計	88,669	94,893

## 5 . 比較連結損益計算書

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

科 目	期 別	前 期	当 期
		自平成14年4月1日 至平成15年3月31日	自平成15年4月1日 至平成16年3月31日
売上高		47,171	62,324
売上原価		35,828	46,531
売上総利益		11,343	15,793
販売費及び一般管理費		( 9,482 )	( 9,846 )
販売費		7,229	7,483
一般管理費		2,253	2,362
営業利益		1,860	5,947
営業外収益		( 297 )	( 146 )
受取利息及び受取配当金		143	23
その他の		153	122
営業外費用		( 897 )	( 765 )
支払利息		279	278
その他の		618	486
経常利益		1,259	5,328
特別利益		( 123 )	( 380 )
投資有価証券売却益		-	198
土地売却益		123	-
その他の		-	182
特別損失		( 1,307 )	( 9,772 )
たな卸資産評価損及び廃却損		903	3,491
固定資産除却損		-	2,216
販売用ソフトウェア廃却損		-	3,423
その他の		404	641
税金等調整前当期純利益または 税金等調整前当期純損失( )		75	4,064
法人税、住民税及び事業税		694	1,044
法人税等調整額		908	1,598
少数株主持分利益		215	273
当期純利益または当期純損失( )		74	3,783

## 6 . 比較連結剰余金計算書

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

	前 期		当 期	
	自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日		自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日	
(資本剰余金の部)				
資本剰余金期首残高				
資本準備金期首残高		11,806		11,806
資本剰余金増加高	-	-	-	-
資本剰余金減少高	-	-	-	-
資本剰余金期末残高		11,806		11,806
(利益剰余金の部)				
利益剰余金期首残高				
連結剰余金期首残高		16,463		15,191
利益剰余金増加高				
1. 当期純利益	74	74		-
利益剰余金減少高				
1. 当期純損失	-		3,783	
2. 配当金	1,121		1,120	
3. 取締役賞与金	12		12	
4. 連結子会社増加による 利益剰余金減少高	212	1,346	-	4,917
利益剰余金期末残高		15,191		10,273

## フ . 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

科 目	期 別	前連結会計年度	当連結会計年度
		自平成14年4月1日 至平成15年3月31日	自平成15年4月1日 至平成16年3月31日
		金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純利益(純損失)		75	4,064
減価償却費		2,579	2,749
連結調整勘定償却額		80	80
退職給付引当金の増加額		312	391
役員退職慰労引当金の増減額		79	95
貸倒引当金の減少額		40	35
受取利息及び受取配当金		143	23
支払利息		279	278
土地売却益		123	-
有形固定資産除却・売却損		48	2,216
投資有価証券・ゴルフ会員権評価損		26	84
販売用ソフトウェア廃却損		-	3,423
投資有価証券売却益		-	198
売上債権の増加額		4,142	10,612
たな卸資産の増減額		198	3,150
仕入債務の増加額		6,283	6,808
取締役賞与の支払額		12	12
その他営業活動による収入(支出)		1,225	1,388
小計		3,719	5,721
利息及び配当金の受取額		143	23
利息の支払額		261	290
法人税等の支払額		408	883
営業活動によるキャッシュ・フロー計		3,193	4,569
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出		20	20
定期預金の払出による収入		20	20
投資有価証券の取得による支出		703	81
関係会社への出資による支出		41	-
投資有価証券の売却による収入		-	474
有形固定資産の取得による支出		3,203	1,715
無形固定資産の取得による支出		497	262
有形固定資産の売却による収入		89	1,741
貸付金の実行による支出		-	356
貸付金の回収による収入		43	31
投資活動によるキャッシュ・フロー計		4,312	167
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金金の増減額		3,309	13,877
長期借入金の実行による収入		5,000	4,100
長期借入金の返済による支出		1,284	5,235
社債の発行による収入		2,000	18,000
社債の償還による支出		-	200
配当金の支払		1,121	1,120
その他財務活動による収入(支出)		35	3
財務活動によるキャッシュ・フロー計		1,248	1,662
現金及び現金同等物に係る換算差額		40	16
現金及び現金同等物の増減額		170	6,048
現金及び現金同等物の期首残高		5,897	6,193
連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加額		125	-
現金及び現金同等物の期末残高		6,193	12,242

## 8 . 連結財務諸表作成の基本となる事項

### 1 . 連結の範囲に関する事項

#### (1) 連結子会社(8社)

(株)東精エンジニアリング、(株)トーセシステムズ、(株)アクレーテック・マイクロテクノロジー、(株)東精クリエイト、(株)アクレーテック・ファイナンス、(株)リープル、ACCRETECH USA, INC.、TOKYO SEIMITSU EUROPE GmbH  
なお、(株)東精クリエイトは、平成16年4月1日付にて、(株)アクレーテック・クリエイトに社名変更しております。

#### (2) 非連結子会社(7社)

(株)東精ボックス、ACCRETECH(MALAYSIA)SDN,BHD.、ACCRETECH(ISRAEL)LTD.、ACCRETECH(SINGAPORE)PTE LTD.、ACCRETECH MICRO TECHNOLOGIES KOREA CO.,LTD.、東精精密設備(上海)有限公司、TOSEI(THAILAND)CO.,LTD  
連結の範囲から除いた理由は、上記7社いずれも小規模会社であり、合計の総資産・売上高・当期純損益及び利益剰余金等の金額がいずれも僅少であり、連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないためであります。

### 2 . 持分法の適用に関する事項

持分法を適用していない非連結子会社7社及び関連会社 三門峡中原精密有限責任公司については、それぞれ連結純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、これらの会社に対する投資については、持分法を適用せず原価法により評価しております。

### 3 . 連結子会社の決算日に関する事項

連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。

### 4 . 会計処理基準に関する事項

#### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

##### (イ) 有価証券

その他の有価証券

時価のあるもの.....連結会計期間末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法による原価法により算定しています。)

時価のないもの.....移動平均法による原価法を採用しております。

##### (ロ) たな卸資産

親会社及び国内連結子会社は、商品・製品・材料及び貯蔵品については、先入先出法による原価法、仕掛品については、個別法による原価法であります。

#### (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

##### (イ) 有形固定資産

親会社及び国内連結子会社は、定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物付属設備は除く)については、定額法によっております。

##### (ロ) 無形固定資産

市場販売目的のソフトウェアは、見込販売数量に基づく方法又は残存有効期間に基づく定額法によっており、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。その他の無形固定資産は、定額法であります。

#### (3) 重要な引当金の計上基準

##### (イ) 貸倒引当金

債権の貸倒の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

##### (ロ) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額基準により計上しております。

##### (ハ) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計期間末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、

当連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額をそれぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理しております。

(二) 役員退職慰労引当金

役員の退任時に支出が予想される役員退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく連結会計期間末支払見込額を計上しております。

(4) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

5. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

## 9. セグメント情報

### (1) 事業の種類別セグメント情報

〔前期〕(平成14年4月1日～平成15年3月31日) (単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

	半導体製造用 機器関連事業	計測機器 関連事業	計	消 去 又 は 全 社	連 結
.売上高及び営業損益					
外部顧客に対する売上高	33,561	13,610	47,171	-	47,171
セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-	-
計	33,561	13,610	47,171	-	47,171
営業費用	34,583	10,727	45,311	-	45,311
営業利益	1,022	2,882	1,860	-	1,860
.資産、減価償却費及び資本的支出					
資 産	71,158	14,303	85,462	3,207	88,669
減 価 償 却 費	2,255	323	2,579	-	2,579
資 本 的 支 出	2,029	303	2,333	-	2,333

〔当期〕(平成15年4月1日～平成16年3月31日) (単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

	半導体製造用 機器関連事業	計測機器 関連事業	計	消 去 又 は 全 社	連 結
.売上高及び営業損益					
外部顧客に対する売上高	47,045	15,279	62,324	-	62,324
セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-	-
計	47,045	15,279	62,324	-	62,324
営業費用	44,272	12,104	56,377	-	56,377
営業利益	2,772	3,174	5,947	-	5,947
.資産、減価償却費及び資本的支出					
資 産	75,630	15,805	91,435	3,457	94,893
減 価 償 却 費	2,401	347	2,749	-	2,749
資 本 的 支 出	2,712	192	2,904	-	2,904

( 2 ) 所在地別セグメント情報

〔前 期〕(平成 14 年 4 月 1 日～平成 15 年 3 月 31 日)

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

	日 本	米 国	ドイ ツ	計	消 却 又は全社	連 結
. 売上高及び営業損益						
外部顧客に対する売上高	37,268	7,440	2,462	47,171	-	47,171
セグメント間の内部売上高又は振替高	5,910	-	-	5,910	( 5,910)	-
計	43,179	7,440	2,462	53,082	( 5,910)	47,171
営業費用	41,299	7,796	2,425	51,521	( 6,209)	45,311
営業利益	1,880	355	37	1,561	298	1,860
. 資 産	83,195	5,316	1,185	89,697	(1,027)	88,669

〔当 期〕(平成 15 年 4 月 1 日～平成 16 年 3 月 31 日)

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

	日 本	米 国	ドイ ツ	計	消 却 又は全社	連 結
. 売上高及び営業損益						
外部顧客に対する売上高	53,210	5,738	3,375	62,324	-	62,324
セグメント間の内部売上高又は振替高	6,365	-	-	6,365	( 6,365)	-
計	59,575	5,738	3,375	68,689	( 6,365)	62,324
営業費用	53,804	5,721	3,252	62,779	( 6,402)	56,377
営業利益	5,770	16	122	5,909	37	5,947
. 資 産	89,471	6,357	1,954	97,784	( 2,891)	94,893

( 3 ) 海外売上高

〔前 期〕(平成 14 年 4 月 1 日～平成 15 年 3 月 31 日)

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

	東アジア	北 米	欧 州	そ の 他	計
. 海外売上高	10,916	7,069	2,826	1,997	22,811
. 連結売上高					47,171
. 連結売上高に占める 海外売上高	23.2%	15.0%	6.0%	4.2%	48.4%

〔当 期〕(平成 15 年 4 月 1 日～平成 16 年 3 月 31 日)

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

	東アジア	北 米	欧 州	そ の 他	計
. 海外売上高	16,774	5,311	3,838	2,983	28,908
. 連結売上高					62,324
. 連結売上高に占める 海外売上高	26.9%	8.5%	6.2%	4.8%	46.4%

## 10. 生産、受注及び販売の状況

### (1) 生産実績

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

事業の種類別 セグメントの名称	前 期		当 期	
	自平成 14 年 4 月 1 日 至平成 15 年 3 月 31 日	前年同期比(%)	自平成 15 年 4 月 1 日 至平成 16 年 3 月 31 日	前年同期比(%)
半導体製造用機器	32,965	+ 62.1 %	47,766	+ 44.9 %
計 測 機 器	14,724	4.2 %	15,473	+ 5.1 %
合 計	47,689	+ 33.6 %	63,239	+ 32.6 %

(注) 金額表示は販売価格(消費税抜き)によっております。

### (2) 受注状況

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

区 分	前 期		当 期	
	自平成 14 年 4 月 1 日 至平成 15 年 3 月 31 日		自平成 15 年 4 月 1 日 至平成 16 年 3 月 31 日	
	受 注 高	受注残高	受 注 高	受注残高
半導体製造用機器	35,240	7,212	54,653	14,821
計 測 機 器	14,007	2,207	16,635	3,564
合 計	49,248	9,420	71,289	18,385

(注) 金額表示は販売価格(消費税抜き)によっております。

### (3) 販売実績

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

区 分	前 期		当 期	
	平成 14 年 4 月 1 日 平成 15 年 3 月 31 日	前年同期比(%)	平成 15 年 4 月 1 日 平成 16 年 4 月 31 日	前年同期比(%)
半導体製造用機器	33,561	+ 62.9 %	47,045	+ 40.2 %
計 測 機 器	13,610	+ 1.1 %	15,279	+ 12.3 %
合 計	47,171	+ 38.5 %	62,324	+ 32.1 %

(注) 金額表示は消費税抜きであります。

## 1 1 . 有価証券の時価等

〔前 期〕(平成 15 年 3 月 31 日現在)

( 1 ) その他有価証券で時価のあるもの

( 単位 百万円 : 百万円未満を切り捨てて表示 )

	取得原価	連結貸借対照表計上	差 額
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株 式	80	93	13
そ の 他	40	40	0
小 計	120	134	14
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
株 式	2,413	1,358	1,055
そ の 他	-	-	-
小 計	2,413	1,358	1,055
合 計	2,533	1,492	1,040

( 2 ) 時価評価されていない有価証券 ( 単位 百万円 : 百万円未満を切り捨てて表示 )

	連結貸借対照表計上額
非 上 場 株 式	914
そ の 他	-
合 計	914

〔当 期〕(平成 16 年 3 月 31 日現在)

( 1 ) その他有価証券で時価のあるもの

( 単位 百万円 : 百万円未満を切り捨てて表示 )

	取得原価	連結貸借対照表計上	差 額
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株 式	723	1,161	437
そ の 他	-	-	-
小 計	723	1,161	437
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
株 式	1,604	1,287	317
そ の 他	-	-	-
小 計	1,604	1,287	317
合 計	2,328	2,448	120

( 2 ) 時価評価されていない有価証券 ( 単位 百万円 : 百万円未満を切り捨てて表示 )

	連結貸借対照表計上額
非 上 場 株 式	862
そ の 他	-
合 計	862

## 12. 退職給付関係

### (1) 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、総合設立の厚生年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けています。国内連結子会社は、退職一時金制度と一部適格退職年金制度を採用しております。

### (2) 退職給付債務に関する事項（平成16年3月31日現在）

（単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示）

イ.退職給付債務	7,603
ロ.年金資産(退職給付信託分を含む)	2,447
ハ.退職給付引当金	3,498
差引(イ-ロ-ハ)	1,657
（差引分内訳）	
ニ.未認識数理差異の未処理額	1,657

### (3) 退職給付費用に関する事項（平成16年3月31日現在）

（単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示）

イ.勤務費用	380
ロ.利息費用	132
ハ.期待運用収益	16
ニ.数理計算上の差異の費用処理額	327
ホ.会計基準変更時差異の費用処理額	-
ヘ.退職給付費用(イ+ロ-ハ+ニ+ホ)	824

### (4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ.退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
ロ.割引率	2.0%
ハ.期待運用収益率	2.5%
ニ.数理計算上の差異の処理年数	10年

## 13. 関連当事者との取引

該当事項はありません。